

明新科技大學 封裝測試產業精英專班 114學年度 第1學期 課表

班級：產技子三甲 (2+2N)

科 目	必選修	學分/時數	任課教師
封裝能力鑑定(一)	必	3/3	潘柏全
Tester設備操作與維修概論	必	3/3	沈添賜(1)
Handler設備操作與維修概論	必	3/3	江培成(1)
HF設備操作與維修概論	必	3/3	江培成(1)
積體電路工程	必	3/3	沈添賜
半導體元件	必	3/3	江培成

合計 18/18

課表&教室	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
第一節 08:30~09:15	封裝能力鑑定(一)	封裝能力鑑定(一)	封裝能力鑑定(一)	封裝能力鑑定(一)	Tester設備操作與維修概論		
第二節 09:15~10:00	封裝能力鑑定(一)	封裝能力鑑定(一)	封裝能力鑑定(一)	封裝能力鑑定(一)	Tester設備操作與維修概論		
第三節 10:10~10:55	封裝能力鑑定(一)	封裝能力鑑定(一)	封裝能力鑑定(一)	封裝能力鑑定(一)	Tester設備操作與維修概論		
第四節 11:00~11:45	半導體元件	積體電路工程	半導體元件	自習	Handler設備操作與維修概論		
第五節 11:45~12:30	半導體元件	半導體元件	半導體元件	封裝能力鑑定(一)	Handler設備操作與維修概論		
午休	午休	午休	午休	午休	午休	午休	午休
第六節 13:30~14:15	半導體元件	積體電路工程	積體電路工程	積體電路工程	Handler設備操作與維修概論		
第七節 14:15~15:00	半導體元件	積體電路工程	積體電路工程	積體電路工程	HF設備操作與維修概論		
第八節 15:10~15:55	積體電路工程	積體電路工程	積體電路工程	積體電路工程	HF設備操作與維修概論		
第九節 16:00~16:45	積體電路工程	半導體元件	半導體元件	半導體元件	HF設備操作與維修概論		
第十節 16:45~17:30	積體電路工程	半導體元件	半導體元件	半導體元件			

	一	二	三	四	五	六	日
w1		9月9日					
w2			9月17日				
w3				9月25日			
w4	9月29日						
w5		10月7日					
w6			10月15日				
w7				10月23日			
w8	10月27日						
w9		11月4日					
w10			11月12日				
w11				11月20日			
w12	11月24日						
w13		12月2日					
w14			12月10日				
w15				12月18日			
w16	12月22日						
w17		2025/12/30 (第一二節-封裝能力鑑定(一)、第三四節-積體電路工程、第五六節-半導體元件)					
w18							

明新科技大學 封裝測試產業精英專班 114學年度 第1學期 課表

班級：產技子四甲 (2+2N)

科 目	必選修	學分/時數	任課教師
測試能力鑑定(一)	必	3/3	沈添賜
BIB治具設備操作與維修概論	必	3/3	江培成(2)
Laser Marker設備操作與維修概論	必	3/3	劉啟文(2)
Lead Scanner原理與應用	必	3/3	江培成(2)
半導體製程實務	必	3/3	張丞勛
實務專題	必	3/3	范揚貴

合計 18/18

課表&教室	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
第一節 08:25~09:10	測試能力鑑定(一)	測試能力鑑定(一)	測試能力鑑定(一)	測試能力鑑定(一)		BIB治具設備操作與維修概論	
第二節 09:15~10:00	測試能力鑑定(一)	測試能力鑑定(一)	半導體製程實務	半導體製程實務		BIB治具設備操作與維修概論	
第三節 10:10~10:55	測試能力鑑定(一)	測試能力鑑定(一)	實務專題	半導體製程實務		BIB治具設備操作與維修概論	
第四節 11:00~11:45	自習	實務專題	實務專題	實務專題		Laser Marker設備操作與維修概論	
第五節 11:45~12:30	測試能力鑑定(一)	實務專題	實務專題	實務專題		Laser Marker設備操作與維修概論	
午休	午休	午休	午休	午休		午休	
第六節 13:30~14:15	實務專題	測試能力鑑定(一)	半導體製程實務	半導體製程實務		Laser Marker設備操作與維修概論	
第七節 14:15~15:00	實務專題	測試能力鑑定(一)	半導體製程實務	半導體製程實務		Lead Scanner原理與應用	
第八節 15:10~15:55	實務專題	半導體製程實務	半導體製程實務	半導體製程實務		Lead Scanner原理與應用	
第九節 16:00~16:45	測試能力鑑定(一)	半導體製程實務	實務專題	實務專題		Lead Scanner原理與應用	
第十節 16:45~17:30	測試能力鑑定(一)	半導體製程實務	半導體製程實務	實務專題			

	一	二	三	四	五	六	日
w1				9月11日			
w2	9月15日						
w3		9月23日					
w4			10月1日				
w5				10月9日			
w6	10月13日						
w7		10月21日					
w8			10月29日				
w9				11月6日			
w10	11月10日						
w11		11月18日					
w12			11月26日				
w13				12月4日			
w14	12月8日						
w15		12月16日					
w16			12月24日				
w17				2025/1/1(第一到第五節不變，第六節改為測試能力鑑定(一)，第七節到第十節不上課)			
w18							